

For All Your Metrology Needs



EnVision

インプラ・アニール後の転位欠陥可視化装置

15nmレベルの転位欠陥を可視化可能な装置。今までプロセスエンジニアの勘と力技で行っていたプロセスの最適化を転位欠陥の可視化で定量的にプロセスのコントロールが実現。

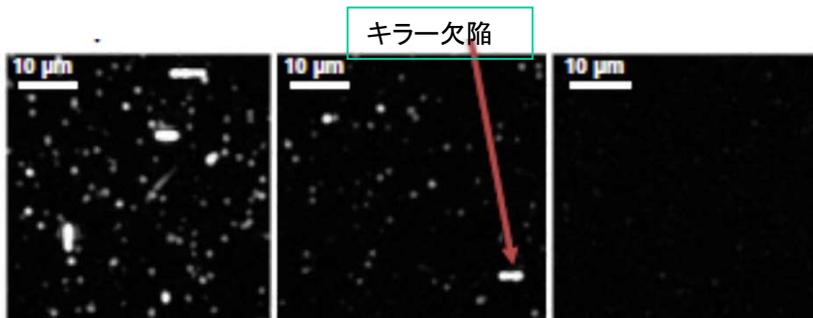
特徴

- 転位欠陥を15nmレベルで可視化。
- 5sec/siteで転位欠陥の面内分布を可視化。(150x180umFOV)
- 3um焦点深度のフォーカスを深さ方向に掘り下げる事により、深さ方向の転位欠陥の位置も特定可能(DTIの深さ方向ダメージの検証にも有効)

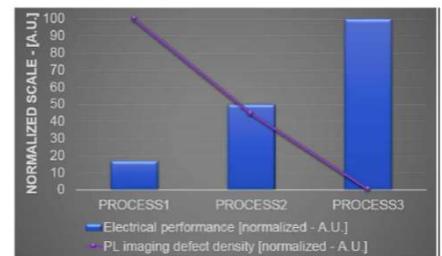
主な測定・評価項目

- PL法を利用した微細転位欠陥可視化装置
- 5Sec/Site
- 150x180umFOV
- 可視化限界: 15nm

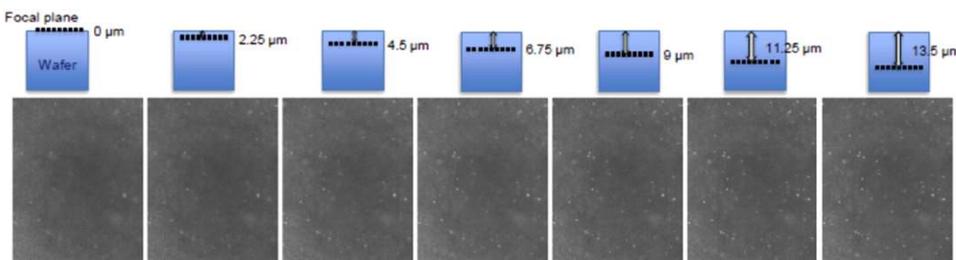
測定データイメージ



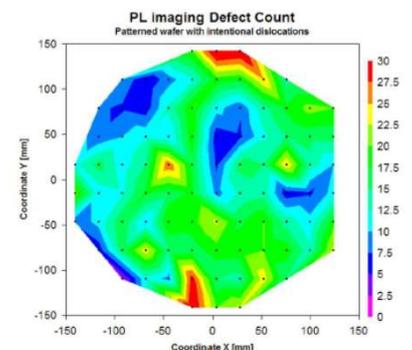
プロセスの最適化



PLイメージ欠陥密度VS電氣的欠陥の相関



表面近傍では確認出来ない深さ方向の応力起因転位欠陥の検証などに有効



面内の転位欠陥分布を短時間に表示可能